

**CAPITOLATO TECNICO RELATIVO A:
INCAPSULAMENTO DI SIPM CUSTOMIZZATI PER LA CALORIMETRIA SHASHLIK IN
PACKAGE PLASTICO RESINATO**

CIG: ZA21A3CBBE

Caratteristiche:

- Package SMD di tipo CSP (Chip Scale Package)
- Le tecnologie di assemblaggio usate devono essere quelle standard dei processi microelettronici
- I materiali impiegati per il package devono essere Ni-free per motivi di compatibilità magnetica
- Copertura totale del die e del bonding e sua protezione tramite resina epossidica
- Trasparenza della resina alla luce visibile
- Massimo spessore del package 1.3mm
- Compatibilità del package con il processo di saldatura per rifusione standard

Il Responsabile del Procedimento
(Marilena Perrone)


